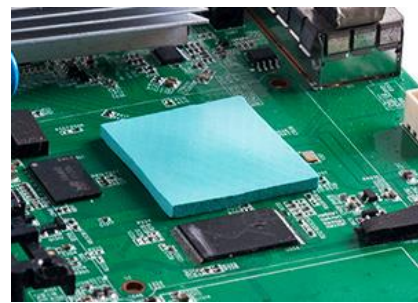


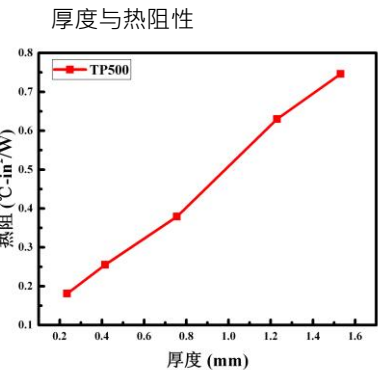
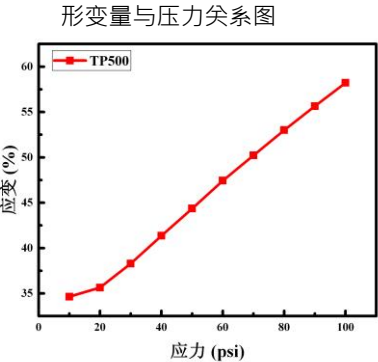
TP500 高性能导热硅胶垫片

特性和优点

- 导热系数: 5.0 W/m.K
- 高导热
- 超低压缩
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 韧性好易操作



TP500导热硅胶片是一款高导热性能的材料,双面自粘,与电子组件装配使用时,低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。在-40℃~150℃可以稳定工作,满足UL94V0的阻燃等级要求。



TP 500 的典型属性

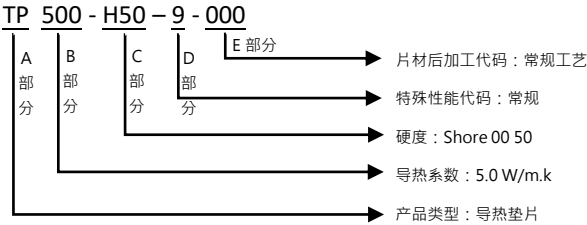
属性	公制值	测试方法
组成部分	硅胶+陶瓷	-
颜色	暗绿色	目视
厚度(mm)	0.5~6.5	ASTM D374
密度 (g/cc)	3.2	ASTM D792
硬度 (Shore OO)	50	ASTM D2240
长期使用温度 (°C)	-40~150	-
电性能		
击穿电压 (Kv/mm)	>6.0	ASTM D149
介电常数 (@10MHz)	7.4	ASTM D150
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹⁰	ASTM D257
防火性能	V-0	UL 94
热性能		
导热系数 (W/m.K)	5.0	ASTM D5470

*厚度 $T \leq 0.75$ mm, 硬度 $H = \text{Shore OO } 55$

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求的模块
- 高速大存储驱动
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

产品编码规则



标准尺寸: $T \leq 1.5$ mm · 尺寸=200x400mm ; $T > 1.5$ mm · 尺寸=150*150. 可依客户指定
模切成各种尺寸或形状。厚度按照0.25mm递增。